证券代码：688249　　证券简称：晶合集成

合肥晶合集成电路股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,567,682,999.65	2,227,893,274.41	15.25
归属于上市公司股东的净利润	135,472,184.74	79,258,819.88	70.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,598,689.06	57,309,730.50	113.92
经营活动产生的现金流量净额	586,407,326.79	394,884,867.30	48.50
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00
加权平均净资产收益率（%）	0.65	0.36	增加0.29个百分点
研发投入合计	337,999,455.77	297,716,502.67	13.53
研发投入占营业收入的比例（%）	13.16	13.36	减少0.20个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	49,197,619,010.94	50,398,579,443.20	-2.38
归属于上市公司股东的所有者权益	21,026,951,705.25	20,870,311,007.81	0.75

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,841,599.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,133.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	12.32	
少数股东权益影响额（税后）	9,225.18	
合计	12,873,495.68	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	70.92	主要系报告期内公司营业收入同比增长，同时公司整体产能利用率维持高位水平，单位销货成本下降，产品毛利率提升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113.92	
经营活动产生的现金流量净额	48.50	主要系本报告期营业收入同比增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加以及客户产能保证金到期返还减少所致
基本每股收益（元/股）	75.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
稀释每股收益（元/股）	75.00	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,318	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				不适用	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	国有法人	468,474,592	23.35	468,474,592	468,474,592	无	0
力晶创新投资控股股份有限公司	境外法人	382,732,181	19.08			无	0
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	其他	328,736,799	16.39	328,736,799	328,736,799	无	0
美的创新投资有限公司	境内非国有法人	51,022,082	2.54			无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	45,145,460	2.25			无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	32,531,829	1.62			无	0
北京集创北方科技股份有限公司	境内非国有法人	26,523,451	1.32			无	0
安徽创谷股权投资基金管理有限公司－合肥中安智芯股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	19,545,003	0.97			无	0
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	17,246,404	0.86			无	0
香港中央结算有限公司	其他	14,925,661	0.74			无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
力晶创新投资控股股份有限公司	382,732,181	人民币普通股	382,732,181				
美的创新投资有限公司	51,022,082	人民币普通股	51,022,082				
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	45,145,460	人民币普通股	45,145,460				
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	32,531,829	人民币普通股	32,531,829				
北京集创北方科技股份有限公司	26,523,451	人民币普通股	26,523,451				
安徽创谷股权投资基金管理有限公司－合肥中安智芯股权投资合伙企业（有限合伙）	19,545,003	人民币普通股	19,545,003				
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	17,246,404	人民币普通股	17,246,404				
香港中央结算有限公司	14,925,661	人民币普通股	14,925,661				
中小企业发展基金（深圳福山有限合伙）	13,202,118	人民币普通股	13,202,118				
芜湖瑞信嘉企业管理有限公司	11,692,349	人民币普通股	11,692,349				
上述股东关联关系或一致行动的说明	合肥建投与合肥芯屏为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无						

注：公司回购专用证券账户不在上述“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示；截至本报告期期末，合肥晶合集成电路股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份62,088,500股，占公司股本总数的3.09%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

1.股份回购实施结果

截至2025年3月5日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份62,088,500股，占公司总股本的3.09%，回购成交的最高价为15.31元/股，回购最低价为12.97元/股，回购均价14.36元/股，支付的资金总额为人民币891,677,308.30元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-011）。

2.实施2025年限制性股票激励计划

公司实施2025年限制性股票激励计划，拟授予激励对象的限制性股票数量为62,088,500股，股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。2025年限制性股票激励计划已获得合肥市国资委批复，尚需股东会审议通过。具体情况详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成2025年限制性股票激励计划（草案）》和《晶合集成关于2025年限制性股票激励计划获得合肥市国资委批复的公告》（公告编号：2025-021）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：合肥晶合集成电路股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,853,233,686.26	5,827,757,156.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,414,590,023.58	1,066,125,485.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,024,256,883.15	992,575,805.60
应收款项融资	1,010,875.06	130,700.90
预付款项	26,948,684.34	37,506,981.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,242,314.27	52,454,283.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,575,526,739.93	1,503,320,597.00
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	63,609,656.29	31,804,828.15
其他流动资产	345,284,750.75	232,190,635.33
流动资产合计	7,349,703,613.63	9,743,866,473.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	176,856,071.10	177,111,034.26
其他权益工具投资	149,360,374.57	134,244,286.06
其他非流动金融资产	809,305,095.84	607,388,589.07
投资性房地产		
固定资产	26,154,655,428.74	24,792,171,704.26
在建工程	12,658,843,941.20	13,221,864,828.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,320.24	857,004.43
无形资产	1,350,755,523.96	1,313,418,835.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	548,105,641.66	407,656,687.42
非流动资产合计	41,847,915,397.31	40,654,712,969.43
资产总计	49,197,619,010.94	50,398,579,443.20
流动负债：		
短期借款	904,947,503.39	1,291,148,136.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,847,396,717.43	2,193,725,786.77
预收款项		
合同负债	361,726,269.40	648,515,899.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	211,534,554.58	170,942,788.74
应交税费	72,356,677.78	95,441,770.18
其他应付款	1,280,090,258.73	1,475,832,452.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,673,438,013.12	1,504,940,952.95
其他流动负债	52,625,002.45	45,217,686.29
流动负债合计	6,404,114,996.88	7,425,765,474.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,317,834,599.94	15,589,429,599.94
应付债券	799,934,081.27	799,888,793.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,707,616.89	7,008,328.32
预计负债		
递延收益	468,063,602.22	487,519,768.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,597,539,900.32	16,883,846,490.56
负债合计	23,001,654,897.20	24,309,611,964.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,006,135,157.00	2,006,135,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,548,724,511.44	18,542,827,472.99
减：库存股	891,776,430.47	891,776,430.47
其他综合收益	78,248,285.75	62,976,811.50
专项储备		
盈余公积	135,942,215.62	135,942,215.62
一般风险准备		
未分配利润	1,149,677,965.91	1,014,205,781.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,026,951,705.25	20,870,311,007.81
少数股东权益	5,169,012,408.49	5,218,656,470.54
所有者权益（或股东权益）合计	26,195,964,113.74	26,088,967,478.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,197,619,010.94	50,398,579,443.20

公司负责人：蔡国智　　主管会计工作负责人：朱才伟　　会计机构负责人：王兴亚

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：合肥晶合集成电路股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	2,567,682,999.65	2,227,893,274.41
其中：营业收入	2,567,682,999.65	2,227,893,274.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,469,491,466.79	2,160,926,550.05
其中：营业成本	1,868,007,446.50	1,671,214,823.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,562,254.66	7,935,173.50
销售费用	15,047,873.87	13,687,238.09
管理费用	88,536,622.65	83,683,919.91
研发费用	337,999,455.77	297,716,502.67
财务费用	150,337,813.34	86,688,892.11
其中：利息费用	124,195,868.23	138,466,869.73
利息收入	13,777,519.46	52,521,910.08
加：其他收益	22,337,871.45	23,510,969.42
投资收益（损失以“-”号填列）	9,251,163.59	19,867,429.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-254,963.16	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,812,467.01	-594,370.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-192,895.64	1,489,968.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,566,732.89	-29,409,398.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,833,406.38	81,831,322.79
加：营业外收入	41,133.55	36,030.21
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,874,539.93	81,867,353.00
减：所得税费用	46,417.24	15,645.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,828,122.69	81,851,707.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,828,122.69	81,851,707.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	135,472,184.74	79,258,819.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-49,644,062.05	2,592,887.82
六、其他综合收益的税后净额	15,271,474.25	-23,577,683.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,271,474.25	-23,577,683.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益	15,116,088.51	-23,308,232.15
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	15,116,088.51	-23,308,232.15
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	155,385.74	-269,451.48
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	155,385.74	-269,451.48
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	101,099,596.94	58,274,024.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	150,743,658.99	55,681,136.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-49,644,062.05	2,592,887.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：蔡国智　　主管会计工作负责人：朱才伟　　会计机构负责人：王兴亚

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：合肥晶合集成电路股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,408,168,543.83	2,073,418,224.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,783,089.44	93,834,800.58
收到其他与经营活动有关的现金	17,038,788.53	56,490,913.48
经营活动现金流入小计	2,435,990,421.80	2,223,743,938.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,031,997.11	809,481,588.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	382,480,519.22	385,030,250.77
支付的各项税费	9,291,873.01	10,273,871.34
支付其他与经营活动有关的现金	416,778,705.67	624,073,360.77
经营活动现金流出小计	1,849,583,095.01	1,828,859,071.55
经营活动产生的现金流量净额	586,407,326.79	394,884,867.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		740,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,583,385.23	20,841,507.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,583,385.23	760,841,507.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,261,592,241.62	7,245,457,097.64
投资支付的现金	646,568,577.76	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,908,160,819.38	7,245,457,097.64
投资活动产生的现金流量净额	-2,898,577,434.15	-6,484,615,590.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	169,000,000.00	6,798,710,582.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	169,000,000.00	6,798,710,582.66
偿还债务支付的现金	732,495,000.00	407,846,802.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,190,854.48	90,446,379.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	768,034.92	2,147,481.00
筹资活动现金流出小计	828,453,889.40	500,440,662.80
筹资活动产生的现金流量净额	-659,453,889.40	6,298,269,919.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,898,249.20	-69,366,506.28
五、现金及现金等价物净增加额	-2,974,522,245.96	139,172,690.37
加：期初现金及现金等价物余额	5,826,894,548.22	6,506,676,332.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,852,372,302.26	6,645,849,022.59

公司负责人：蔡国智　　主管会计工作负责人：朱才伟　　会计机构负责人：王兴亚

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688249　　证券简称：晶合集成　　公告编号：2025-023

合肥晶合集成电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等）。

● 投资金额及期限：合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）使用额度不超过人民币15亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

● 已履行的审议程序：公司于2025年4月28日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

● 特别风险提示：本次现金管理方式是使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年5月9日出具的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）501,533,789股。公司每股发行价格19.86元，募集资金总额为9,960,461,049.54元，扣除发行费用236,944,589.63元后，募集资金净额为9,723,516,459.91元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月26日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2023年5月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

单位：人民币亿元

序号	项目名称	拟使用募集资金额
1	合肥晶合集成电路先进工艺研发项目	49.00
1.1	后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含90纳米及55纳米）	6.00
1.2	微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）	3.50
1.3	40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目	15.00
1.4	28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目	24.50
2	收购制造基地厂房及厂务设施	31.00
3	补充流动资金及偿还贷款	15.00
合　计		95.00

注：公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，公司拟终止“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”，并将该项目拟投入募集资金变更投向至“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”。上述事项尚需提交公司股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年1月1日披露于上海证券交易所网站的《晶合集成关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》（公告编号：2025-002）。

截至2024年12月31日的募集资金使用情况详见公司2025年4月21日披露于上海证券交易所网站的《晶合集成2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东利益。

（二）现金管理产品品种

公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等）。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）额度及期限

公司拟使用额度不超过15亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（四）实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述期限及额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）收益的分配方式

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

四、现金管理的风险及其控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述期限及额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目实施和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、履行的决策程序

公司于2025年4月28日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，使用不超过人民币15亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。本议案相关事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，监事会同意公司使用不超过人民币15亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司已履行了相关内部决策程序；公司通过购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，有利于提高资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定。

综上，保荐机构对公司本次拟使用不超过人民币15亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688249　　证券简称：晶合集成　　公告编号：2025-024

合肥晶合集成电路股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司（含合并报表范围内子公司）在确保不影响公司日常经营业务开展及资金安全的前提下，使用不超过人民币80亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现就该事项的具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理品种

公司拟通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理，投资品种为安全性高、流通性好、中低风险、稳健型投资产品。

（三）额度及期限

公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币80亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，授